

報道発表

お問い合わせ先：

David Moreno

Open Sky Communications

Tel: +1-415-519-3915

E-mail: dmoreno@openskypr.com

EBEAM INITIATIVE による半導体業界の著名人を対象にした調査が、今年のフォトマスク市場の継続的な成長を予測

EBEAM INITIATIVE が AGC を新メンバーとして迎える

2025 年 9 月 23 日、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ市 発

電子ビーム (eBeam) 技術に基づく新しい半導体製造アプローチの情報共有と促進を目的としたフォーラムである eBeam Initiative は、本日、第 14 回年次 eBeam Initiative Luminaries Survey の完了を発表しました。今年の調査には、フォトマスク、電子設計自動化 (EDA)、チップ設計、装置、材料、製造、研究など、半導体エコシステム全体にわたる 51 社の業界を代表する有識者が参加しました。eBeam Initiative は、AGC が最新メンバーとして加入したことも発表しました。

調査の主なポイント

調査に回答した著名人の 64% は、2025 年のマスクの売上高は 2024 年に比べて増加すると予測しており、これは SEMI の 2025 年の前年比 5% 成長予測⁽¹⁾ と一致しています。新しい調査項目では、マスク描画が 2026 年の最先端への投資の最優先事項としてランク付けされ、マスク検査とリペア、光近接効果補正 (OPC) / Inverse Lithography Technology (ILT) が僅差でそれに続きました。関連する質問では、調査回答者の 88% が、マルチビームマスクライターの購入が今後 3 年間にわたって継続的に増加すると予測しています。

EUV リソグラフィと曲線マスクは、フォトマスク市場に影響を与える 2 つの重要な技術トレンドです。High-NA EUV リソグラフィは最先端ノードをターゲットとしており、現在開発が進められています。High-NA EUV がマスクメーカーに与える影響についての質問では、現在、マスクの Sub-Resolution Assist Features (SRAF) に必要な最小寸法は 15nm 以下であると考えている有識者は 40% で、昨年の 29% から増加しています。曲線マスクに目を向けると、曲線マスク形状の製造に対する自信は引き続き高く、回答者の 77% が、最先端のマスクショップは来年末までには少なくとも限られた数の曲線マスクを大量生産 (HVM) で処理できると回答しています。

Luminaries Survey の全ての結果は、カリフォルニア州モンレーで開催される SPIE フォトマスクテクノロジー + EUV リソグラフィカンファレンスに合わせて開催される eBeam Initiative のイベントで発表され、専門家パネルによって議論される予定です。

この調査結果はイベント終了後、www.ebeam.org からダウンロードできるようになります。AGC は、このイベントで、eBeam Initiative の 50 社を超える企業に加わった最新メンバーとして紹介されます。

eBeam Initiative の運営会社スポンサーであり D2S の CEO である藤村 晶氏は次のように述べています。「AGC が eBeam Initiative に加わることを大変嬉しく思います。フォトマスク市場の継続的な成長は、マスクのサプライチェーンのあらゆる部分が半導体製造の残りの部分にとっていかに重要になっているかを浮き彫りにしています。フォトマスク基板の大手プロバイダーである AGC は、業界全体の意識向上と連携の促進に向けた共同の取り組みを強化する独自の視点をもたらします。」

参照

(1) Source: [Photomask Market Characterization Study](#), SEMI, August 8, 2025

eBeam Initiativeについて

eBeam Initiativeは、電子ビーム(eBeam)技術に基づく新しい半導体製造アプローチに関する情報共有および啓発活動のフォーラムを提供します。このInitiativeの目標は、導入の障壁を減らし、より多くの集積回路(IC)の設計着手を実現し、市場投入までの時間を短縮できるようにするとともに、半導体エコシステム全体を通じてeBeamテクノロジーへの投資を増やすことです。メンバーは半導体エコシステム各方面から構成され、次にあげる各社、各機関で構成されています。aBeam Technologies; アドバンテスト(Advantest); AGC株式会社(AGC); Alchip Technologies; AMD; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; ASML; Averroes.ai; Cadence Design Systems; キヤノン(Canon); GEA-Leti; D2S; 大日本印刷(Dai Nippon Printing); EQUIcon Software GmbH Jena; ESOL; EUV Tech; Fractilia; Fraunhofer IPMS; 富士フイルム株式会社(FUJIFILM Corporation); 富士通セミコンダクター(Fujitsu Semiconductor Limited); GenISys GmbH; GlobalFoundries(GF); Grenon Consulting; 日立ハイテク(Hitachi High-Tech Corporation); HJL Lithography; ホロン株式会社(HOLON CO., LTD.); HOYA株式会社(HOYA Corporation); IBM; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; 日本電子(JEOL); キオクシア(KIOXIA); KLA; Micron Technology; Multibeam Corporation; 日本コントロールシステム(NCS); ニューフレアテクノロジー(NuFlare Technology); Petersen Advanced Lithography; Photonics; QY Mask; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation(SMIC); Siemens EDA; STMicroelectronics; Synopsys; TASMITE; 東京エレクトロン(TEL); TOOL株式会社(TOOL Corporation); テクセンドフォトマスク株式会社(Tekscend Photomask); UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; 及び ZEISS。

電子業界に属する会社・機関であればどなたでも eBeam Initiative に加盟できます。詳しくは www.ebeam.org をご覧下さい。